

## アルファードesign、基板実装装置事業を強化－基板実装装置の新機種投入

【長野】アルファードesign(長野県東御市、森沢正良社長、0268・64・0088)は、形状が異なる電子部品やジャンパー線をプリント基板に複合挿入できる基板実装装置を開発した。6月に投入する。高精度、均一に防湿剤をコーティングできる装置も同時に投入する。生産効率の向上につながるとして基板実装関連のメーカーに導入を提案する。ラインアップを拡充し、基板実装装置事業を底上げする。

複合挿入機「ボードペッカー AMR-II」は電子部品のアキシャル部品とラジアル部品をプリント基板に挿入できるほか、従来機を改良してジャンパー線を挿入する機能を追加し、1台で3種に対応できるようにした。基板に複合挿入できるアキシャル部品とラジアル部品は20品種。専用挿入機を2台導入する場合に比べ初期投資を3分の1程度に抑えられるという。価格は2500万円に設定。専用挿入機からの買い替えなどで、年間40台の販売を見込む。

防湿剤を基板に塗るためのコーティング装置2機種も投入する。普及モデルの「ACM-110」は370ミリ×500ミリメートルの大型基板に対応、毎秒700ミリメートルを高速塗布できる。上位モデルの「ACM-200」は基板をカメラ撮影して防湿剤を塗る部分を指定することにより、均一に高精度で塗布できる。価格はACM-110が700万円、ACM-200が900万円。2機種を合わせて年間140台の販売を見込む。